

金刚石-铜复合热沉片

金刚石/铜复合材料是一种先进的热管理材料，
它兼具金刚石极高的热导率和金属铜优良的加工性、可镀性。

该材料具有优异的热物理性能，其热膨胀系数可调，
能够与半导体芯片材料（如砷化镓GaAs、氮化镓GaN、碳化硅SiC等）
实现良好的热匹配，
有效解决高功率密度电子器件（如第三代半导体芯片）的散热问题。

它是传统热沉材料（如Cu/W、Cu/Mo等）的理想升级替代品，
在高功率、高频率、高集成度的特殊电子应用领域前景广阔。

DIAMOND COPPER
HEAT SINK

CUFENG

核心优势

极速散热 性能不掉线

热导率高达600–800 W/m·K，
迅速导出芯片热量，
确保高功率器件持续高效运行。

热膨胀匹配 告别热应力损伤

热膨胀系数可调，与GaAs、GaN、
SiC等半导体较好匹配，
大幅提升器件可靠性与寿命。

易加工、好集成 支持定制化设计

表面可镜面抛光、激光打孔、
丝印刻蚀，支持焊接与封装，
快速融入您的产品体系。

高温稳定 无惧严苛环境

在300°C高温下仍保持性能稳定，
适用于车载、航天、工业等
高要求场景。

技术参数

型号	密度 (g/cm ³)	热导率 (W/m · K)	热膨胀系数 ($\times 10^{-6}/K$)	抗弯强度 (MPa)
CF-600	5.5	600	8	≥300
CF-700	5.3	700	7	≥300
CF-800	5.1	800	6	≥300

电话: 15305191423

邮箱: wangbo@tospike.com

地址: 江苏省南京市江北新区行知路2号2栋9层909室

Email:wangbo@tospike.com

Add:Room909, 9th floor,Building 2,No.2 Xingzhi Road,
Jiangbei New District,Nanjing,Jiangsu